

# 石川県次世代産業育成講座・ 新技術セミナー

## はんだ材料の動向と実装現場の課題 ～品質確保と後工程対応～

### 【概要】

電子部品や半導体部品と基板の接続に用いられる「はんだ」の材料面に焦点を当て、コストパフォーマンスの高い低銀はんだ、植物性由来の新素材であるセルローズナノファイバーを意図的に添加したはんだなど、はんだ材料の最新動向を紹介いたします。

これらの材料は、今後さらなる採用拡大が見込まれており、電子機器の高機能化・小型化や高密度実装の進展との関連性がますます重要となっています。

さらに、信頼性および生産性に関する技術課題にも触れ、昨今課題になっている後付け部品のはんだ付けに関する各種工法についても取り上げます。ぜひご参加ください。

日 時 令和8年8月27日（木） 13:30～15:30

形 式 ZoomによるWeb配信

※お申込みされたE-mailアドレスにWeb接続URLを送信します。

講 師 松尾ハンダ株式会社  
営業部

部長 川島 淳 氏

定 員 20名程度

受講料 無 料

お申込み 下記のURLからお申込みください。

<https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31195644.html>

締 切 令和8年8月20日（木）

担 当 石川県工業試験場 電子情報部 研究主幹 奥谷 潤

お問合せ 公益財団法人 石川県産業創出支援機構  
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当  
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)  
E-mail: j-seminar@isico.or.jp TEL:(076)267-8081

主 催 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協 力 石川県工業試験場

